

INFORMATION MEETING ***2006***

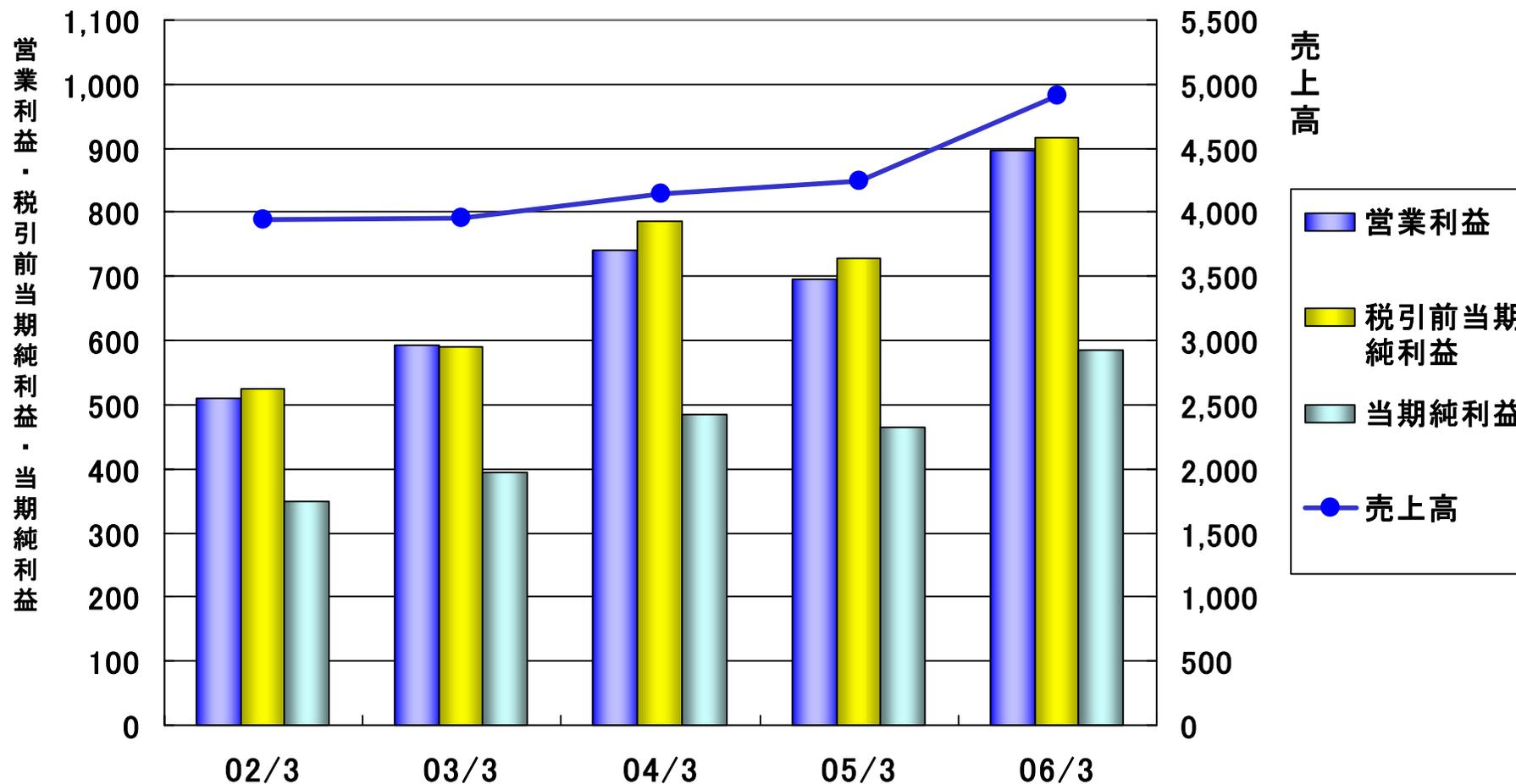
株式会社 村田製作所

売上高及び利益の推移



(億円)

(億円)



(注)04/3期の営業利益には、厚生年金基金代行返上による117億円の増益要因が含まれております。

2005年度業績概況



	2004年度	2005年度	前期比
売上高	4,245億円 (100.0%)	4,908億円 (100.0%)	+663億円 (+15.6%)
売上総利益	1,689億円 (39.8%)	1,948億円 (39.7%)	+260億円 (+15.4%)
営業利益	695億円 (16.4%)	898億円 (18.3%)	+203億円 (+29.2%)
税引前利益	729億円 (17.2%)	917億円 (18.7%)	+188億円 (+25.8%)
当期純利益	466億円 (11.0%)	584億円 (11.9%)	+119億円 (+25.5%)

※()内の数値は売上高比または増減率

2006年度業績見通し



	2006年度 上期	2006年度 下期	2006年度 通期
売上高	2,650億円 (+15.8%)	2,750億円 (+5.0%)	5,400億円 (+10.0%)
営業利益	480億円 (+26.7%)	540億円 (+3.9%)	1,020億円 (+13.5%)
税引前利益	495億円 (+25.9%)	555億円 (+6.0%)	1,050億円 (+14.5%)
当期純利益	310億円 (+25.0%)	350億円 (+4.0%)	660億円 (+12.9%)

※ ()は、半期は前年同期比伸び率、通期は前期比伸び率

電子機器生産台数の増加による需要の拡大



<主要電子機器の生産台数(当社推計値)>

(単位:百万台,%)

		2005 年度	2006 年度	前期比
携帯電話	販売	754	864	+15%
	部品需要	826	948	+15%
パソコン	販売	201	224	+11%
	部品需要	222	242	+9%
液晶テレビ	生産	21	42	+100%
PDPテレビ	生産	6	11	+80%
デジタルカメラ	生産	91	97	+7%
DVDレコーダー	生産	18	25	+42%

高機能化、デジタル化による部品需要の増加、 需要構造の変化



ー 携帯電話

・第3世代機の普及、高機能化

- カラー化、カメラ搭載、Bluetooth[®](注)機能搭載、地上デジタル放送対応
- 1台あたりに使用される当社の電子部品は1.5倍～2倍に

ー PC

・MPUのデュアルコア化

- 用途特化型、大容量セラミックコンデンサの需要金額の拡大
- シングルコアに比べデュアルコアの需要金額は2倍

ー 薄型TV

・生産の急拡大

- 32インチ以上大型ディスプレイでは700～1400個のセラミックコンデンサを使用
(15インチサイズのブラウン管テレビでは200個程度)



電子部品の新たな需要の創出

「ユビキタス社会」の進展

- 無線通信

携帯電話、無線LAN、Bluetooth[®] は既に大きな市場
UWB、Zigbee、WiMaxなど新しい技術への進化

- 地上デジタル放送

DVB-H方式による携帯電話のデジタル放送
世界的な広がりを期待



成長の期待される分野を多く抱える

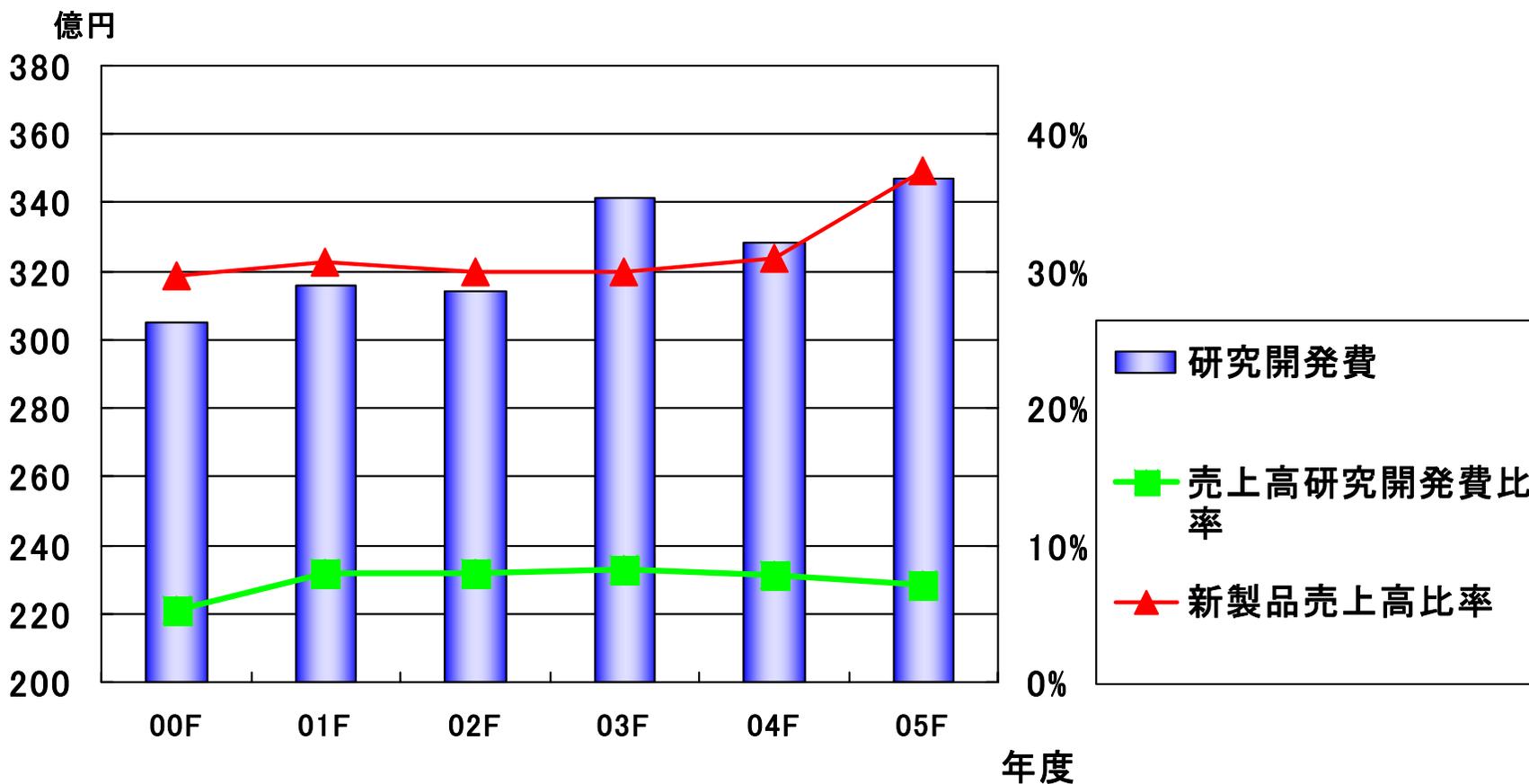
カーエレクトロニクス

- ハイブリッド車の普及の伸展
- 車内LANの拡大
- RKE(Remote keyless Entry)、TPMS(Tire Pressure Monitoring System)
- カーナビ、ETC(Electronic Toll Collection)
- DSRC(Dedicated Short Range Communication)サービスの開始



カーエレクトロニクス市場の一層の拡大を期待

研究開発費、新製品売上高の推移



特許件数

	日本	米国	海外 (除 米国)
特許登録件数 (2005年)	408件	228件	747件
特許登録保有件数 (2005年12月末現在)	5,102件	3,660件	6,192件

- 特許の出願件数は業界でトップクラス
- 2005年の米国での特許登録件数は日系電子部品メーカーで1位
- 特許件数だけでなく、特許の質を重視する知的財産戦略

中期的な需要の拡大



電子部品需要

電子機器の生産台数拡大

デジタル化、高機能化（需要構造の変化）

数量ベースで今後2～3年は年率2桁以上の拡大

当社の取り組み

- ・積極的な研究開発活動（対売上高比7～8%）
- ・新製品売上高比率の向上（目標：40%）
- ・知的財産の有効活用

当社の高機能の新製品は、市場の拡大以上の成長

設備投資計画



(単位:億円)

	2005年度	2006年度	前期比
生産設備	315	450	+135
研究開発設備	69	80	+11
建物・土地	49	200	+151
その他	77	70	▲7
合計	510	800	+290

《生産設備》

コンデンサ、Bluetooth[®] モジュール、表面波フィルタ
多層デバイス など

《土地・建物に対する投資》

コンデンサ、多層デバイス、電源、原材料の生産棟

コンデンサ、圧電製品、ノイズ対策製品
→セラミック材料の特性をいかす

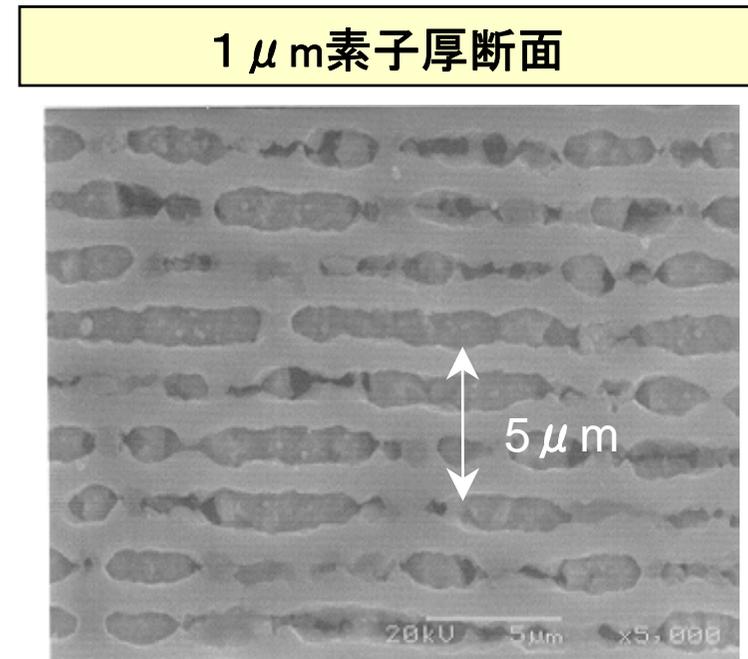


- ・高度な機能を持つ新製品を量産化
→高いシェアを確保
- ・セラミック材料の生産から手がける
→高い収益性を持つ

小型大容量化により急拡大する大容量品

- 1.0 μm の薄層誘電体を用いた大容量コンデンサの早期量産化
 - 1608サイズ10 μF 品、2012サイズ22 μF 品の売上拡大
 - 3216サイズ100 μF 品の商品化を実現、2012サイズ100 μF 品の商品化を計画

小型大容量品の製品群を拡充



- 電解コンデンサからセラミックコンデンサへの置き換え促進
- 小型化、高機能化が進んでいる携帯電話、PC、デジタルAV機器、ゲーム機向けの需要拡大

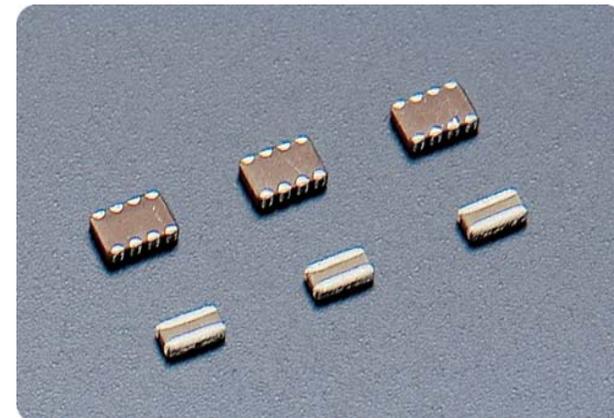
MPU高機能化による用途特化型品の拡大

・低ESLコンデンサ

ー高いシェア

ーMPUのマルチコア構成比率が急速に上昇しており、低ESLコンデンサや大容量コンデンサの需要拡大が見込まれる

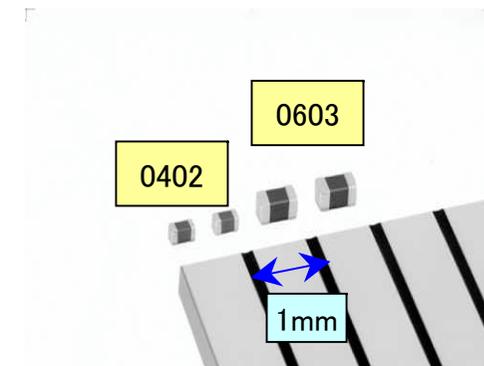
ーゲーム機やカーエレクトロニクス市場への広がり



チップ積層セラミックコンデンサ(低インダクタンスタイプ)

電子機器の高機能化に貢献する小型品

- ・0603サイズ
 - 電子機器の小型化、高機能化とともに売上拡大
 - 売上高は、年率50%程度伸長
 - 携帯電話のパワーアンプモジュールや本体ボード、デジタルカメラ、携帯型ゲーム機での搭載が進む
- ・0402サイズ
 - 業界に先駆け商品化
 - 携帯電話のパワーアンプモジュールで採用



0.4×0.2mm、0.6×0.3mmサイズ
セラミックコンデンサ

収益構造の改善

大容量品、用途特化型品、0603サイズの
高い付加価値をもった製品の売上高は、
コンデンサの内の半分以上を占める



高い技術力を背景に、高機能の新製品を
創出しつづけることで、同業メーカーとの
差別化を図り、収益性を改善

機器のデジタル化、高機能化による需要の高まり

電子機器のデジタル化、高機能化に伴う
ノイズ対策の重要性の高まり



当社のノイズ対策部品売上高は、
値下がりを吸収し、過去数年間にわたり増加

ノイズ対策部品（エミフィル、チップコイル）



・チップインダクタ（BLM）

－PDPTVでは約80個/台の需要

・チップ3端子型コンデンサ（NFM）

－電源ラインのノイズ対策に特性を発揮

－DVDレコーダーでは約15個/台の需要

・チップコイル（LQW/LQG/LQP）

－携帯電話のデジタル化、多機能化により売上増加

－携帯電話では約30個/台の需要

・チップコモンモードチョークコイル（DCC）

－高速インターフェースで発生するノイズを効果的に除去



BLM Series



NFM21P Series



LQW/LQG/LQP Series

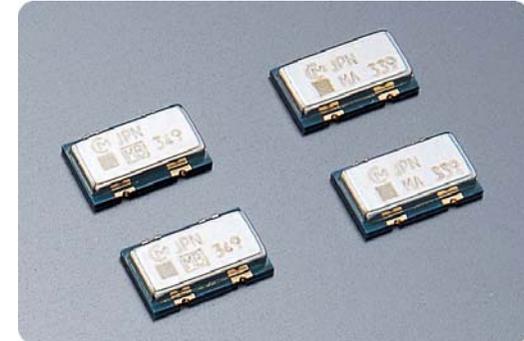


DLP/DLW31S Series

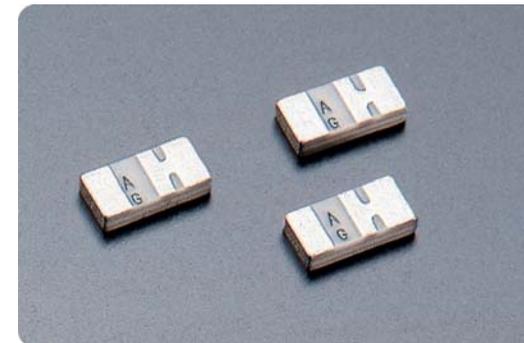
センサ関連製品



- ジャイロスター[®]
手ブレ補正機能用
デジタルスチルカメラで採用拡大
高いシェア



- ショックセンサ
HDD振動検知用
高いシェア



センサ関連製品は2005年度の売上高は3割以上増加

センサ関連製品の用途の広がり

- カーナビゲーションシステム用MEMSジャイロ
- エアバック用ショックセンサ
- ゲーム機向けセンサ関連製品



さまざまな分野での広がりを期待

表面波フィルタ

需要の拡大

- ・携帯電話の生産台数の拡大
- ・マルチバンド化により1台当たりの使用数量増加
(従来: 2~3個/台 ⇒ 第3世代機種: 6~7個)

当社の取り組み

- ・複合化、小型化の要求に応えるチップサイズパッケージ技術
(デュアル表面波フィルタ、表面波デュプレクサ)
- ・納期、サービスの対応

高周波表面波フィルタはトップシェアに迫る

得意先へのデザイン・インによるモジュール事業の拡大

- 得意先メーカーのモジュールでの調達指向
- チップ部品をモジュール部品で使用するることによるグループ全体としてのシナジー効果
- 得意先へのデザイン・イン活動の推進



モジュール事業の拡大を図る

Bluetooth[®] モジュール



- Bluetooth[®] 機能の携帯電話搭載率（当社推計値）

2004年度 実績	2005年度 実績	2006年度 予想
10%	25%	35%

数年後に50%
まで向上

- Bluetooth[®] モジュール売上高

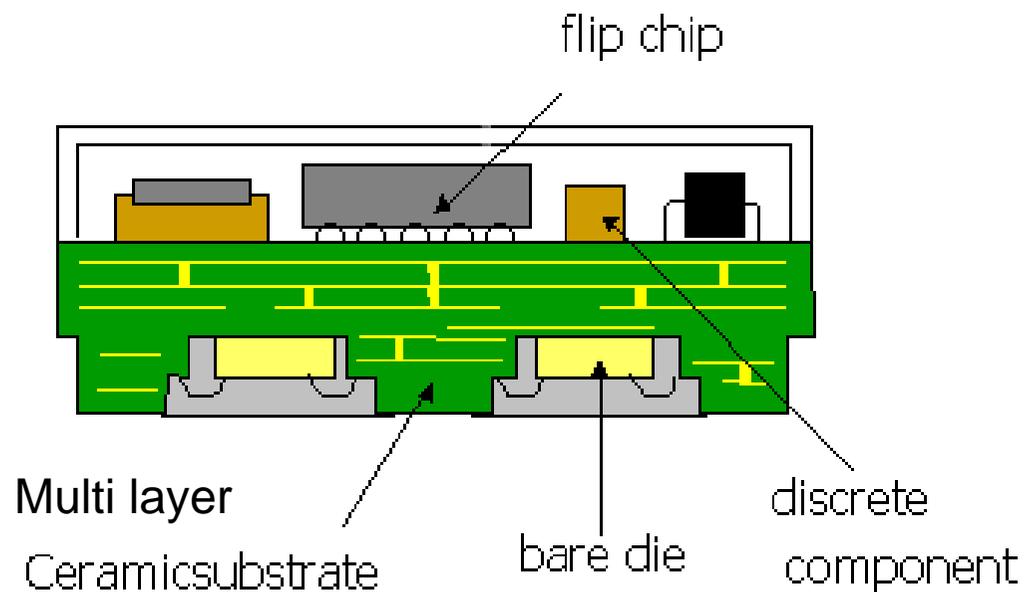
2004年度 実績	2005年度 実績	2006年度 計画
150億円	450億円	640億円

携帯電話市場で
高いシェアを確保

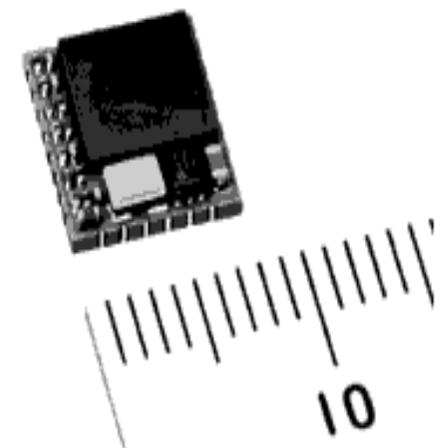
Bluetooth[®] モジュール



〈構造図〉



〈写真〉



米国SyChip社の買収



- 買収金額: 約137百万US\$

- 目的:

① 無線LANモジュール事業の拡充

VoIP(成長市場)、POS端末・PDA(ニッチ市場)での当社との補完関係

② ソフトウェア対応力の拡充による通信モジュール事業の強化

SyChipのソフトウェア技術、ソフトウェアサポート力を当社のLTCC技術を武器としたモジュール事業に活用

無線LANモジュールやBluetooth[®]、UWBなどの各種無線通信用モジュール事業拡大への貢献

③ 新たな技術領域の強化・拡充

IPD(Integrated Passive Device)技術の獲得

- SyChip社人員: 総人員70名(うち技術開発人員56名)

新たな技術の広がりを見せる
無線通信市場
〔 無線LANやBluetooth[®] から
UWB、WiMax、Zigbeeへ 〕

当社の取り組み

- ・現状の無線通信市場で培ったLTCC技術を無線通信用モジュールに展開
- ・M&Aにより取得したIPD技術やソフトウェア技術を活用

電子部品トップメーカーとしての地位を
さらに強固なものにする

1株当たり配当金



	中間	期末	通期
2004年度 実績	25円	25円	50円
2005年度 実績	30円	40円	70円
2006年度 計画	40円	40円	80円

総還元性向



		2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	計
①当期純利益		395億円	485億円	466億円	584億円	1,930億円
②自己株式取得額 (平均取得価格)		480億円 (5,467円)	321億円 (5,534円)	271億円 (5,511円)	156億円 (5,540円)	1,229億円 (5,503円)
③配当額		119億円	116億円	113億円	155億円	503億円
④配当性向	③÷①	30%	24%	24%	27%	26%
⑤自己株式取得額÷当期純利益	②÷①	122%	66%	58%	27%	64%
⑥総還元性向	(②+③)÷①	152%	90%	82%	53%	90%

* 配当額は利益処分より算出している。

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があります、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1) 当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2) 原材料等の価格変動及び供給不足、(3) 為替レートの変動、(4) 変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5) 当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6) 各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7) 偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。

